

作成日 2004年1月15日

三井化学(株)

技術資料 / A - 02

AURUM PI-PA

AURUM PI-PAは、ガラス転移温度 258 と、従来のオーラム（ガラス転移温度 250 ）よりも更に耐熱性を向上しております。

押し出し成形性が、従来のオーラム よりも改善されており、ストックシェイプの製造にも適しています。

結晶化速度が遅く、事実上非晶です。

表 - 1:PI-PA と PL450C との比較

項目	単位	AURUM PI-PA	AURUM PL450C
〔一般物性〕			
融点	°C	380	388
ガラス転移温度	°C	258	250
Mi値	400 ,1.05kg	8	4.5-7.5
結晶化速度	t1/2min	100	10-15
結晶化温度	Tc °C	320	330
〔機械物性〕			
引張り強度	MPa	95	92
引張り伸び	%	82	90
曲げ弾性率	MPa	3030	2940
〔成形条件〕			
シリンダー温度	°C	380-420	390-420
金型温度	°C	180-200	180-200

記載の内容は、現時点で入手できた資料、情報、データ等に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をするものではありません。